

东微半导 20260824

东微半导体：AI 驱动低压与 SiC 业务爆发，向功率+IC 方案商转型

摘要

- 业务转型与增长极：公司正从功率器件商向“功率+IC”解决方案商转型，低压器件受 AI 电源需求驱动成为新增长点，营收占比拟在 1-2 年内升至 50%以上。
- AI 领域深度渗透：实现 AIDC 一、二、三侧电源全覆盖，SiC 产品进入全球头部供应链；收购慧能泰补齐数字控制器 IC 短板，预计 2026 年下半年开始放量。
- 盈利质量稳步提升：2026H1 剔除股份支付后扣非净利同比增长 44.39%；通过产品升级与 IC 叠加策略传导供应链成本压力，规模效应正逐步显现。
- 产能与供需格局：预计半导体供应链紧张将持续至 2027 年，公司通过锁定华虹、跃芯等 Fab 产能并开拓新供应商，以应对 AIDC 及车规级需求的快速反弹。
- 新兴赛道布局：SiC 业务预期实现数倍至两位数倍增长；SGT 低压器件已在人形机器人关节电机领域批量出货，并预研氮化镓驱动模组等前瞻方案。
- 研发与 AI 赋能：研发投入随 IC 团队并入显著增加，计划利用 AIAgent 辅助 IC 开发以提升人效，重点立项 800V 及 48V 系统差异化电源芯片，避开低端竞争。

Q&A

请问公司 2026 年上半年的下游收入结构是怎样的？各个业务板块的表现有何差异？

2026 年上半年，公司业务结构最显著的变化是低压器件的快速放量。低压器件在 2025 年高速增长的基础上，今年上半年同比增长超过 60%，其中二季度的增长尤为显著。这一增长主要得益于 AI 电源领域对中低压器件需求的急剧增加，在一块电源板上，高压与低压器件的数量比例差距可达两位数。低压器件业务已成为公司新的增长点，其在营收中的占比正迅速提高，而高压产品的占比则相应持续下降。鉴于低压器件市场的整体规模是高压市场的好几倍，我们认为该领域的未来成长空间非常可观。从下游应用领域来看，各板块增速呈现差异化：AI

领域的应用增长最快，公司在国内所有顶级的 AI 数据中心电源客户中均已实现批量供货，部分客户的采购量非常大。光伏储能领域在第二季度也表现出明显的增量，公司已向大部分头部客户批量供货，IGBT 产品的增量也很快。汽车业务在第一季度受到较大影响，但第二季度已有所恢复，目前也处于供需关系比较紧张的阶段。为应对快速增长的需求，公司正积极布局更多低压器件产能，并拓展上游供应链，新增产能已取得良好进展，为未来的增长奠定了基础。

面对 AI 数据中心这一高景气度赛道，公司在产品布局、客户拓展方面有何具体进展？对该领域的后续发展空间有何判断？

公司在 AI 数据中心电源领域实现了从一次、二次到三次侧电源的全面覆盖。产品布局包括最新的超结 MOSFET、SGT MOSFET、碳化硅器件以及高密度功率模块，这些产品均已进入头部客户。结合对慧能泰的收购，公司的数字控制器 IC 也已导入全球顶级头部客户，预计下半年将开始放量，这将持续提升公司在 AI 领域的渗透率。特别是在碳化硅产品方面，公司已作为国内极少数的供应商成功进入全球头部客户的供应链。这得益于公司产品不仅在单体性能和成本上具备优势，更在动态性能和可靠性方面得到客户认可。公司的策略是专注于高性能应用市场，而非低毛利的红海市场。为支撑未来增长，保障产能是当前工作的重中之重。公司正在与供应商锁定明年乃至更长期的产能供给，并已开拓了新的晶圆生产供应商。在 IC 产品层面，公司围绕高压 HVDC、AI DC 以及 800V 应用进行了大量立项，相关规划已在再融资计划中完整披露。这些新立项的电源芯片产品旨在通过差异化竞争，结合公司在功率器件领域的特点，避免低端同质化竞争。目前，公司正从功率器件供应商向提供整体 AIDC 和新一代电力电子系统解决方案的供应商转型。除了已并表的慧能泰，公司还有更多产品正在研发、送样或测试中，例如高端 DSP、AFE 等产品已在与客户互动，部分已获得 design in 或实现小批量供货。因此，公司未来的增长将是多维度的，预计下半年及全年的业绩表现将非常乐观。

公司 2026 年上半年归母净利润实现大幅增长，但扣非归母净利润承压，请问如何看待公司主业的盈利能力趋势？未来有何优化措施和预期？

公司主业的盈利能力呈现稳步改善的良好态势。2026 年上半年扣非归母净利润数据承压，核心原因是公司持续加大研发投入、扩充人才团队所带来的战略性投入，以及股权激励产生的股份支付费用摊销。如果剔除股份支付费用的影响，上半年扣非归母净利润为 1,404.43 万元，较去年同期增长 44.39%，这表明主营业务的经营质量实际上是在稳步提升的。

请介绍一下公司 2026 年上半年的整体经营表现、盈利能力以及现阶段的核心战略重点？

2026 年上半年，公司净利润实现了大幅增长，部分得益于投资产生的浮盈。在扣除非经常性损益后，若剔除股份支付的影响，主营业务的净利润同比增长接近

50%，显示出盈利能力的显著改善。现阶段，公司的核心战略是扩大产品在客户端的覆盖面，夯实市场基本盘。基于对未来几年供需关系将持续紧张的判断，公司正积极争取更多供应链产能支持。同时，在客户端大力推进 design-in，尤其是在 AI 领域的客户，这些客户正在为国内外云服务厂商提供电源方案，需要将公司的器件纳入其客户端进行认证。因此，抢占先机并稳固市场地位至关重要，这将为未来数年乃至更长远的发展奠定良好基础。为实现此战略目标，公司一方面需要承担供应链成本的增长，另一方面则要积极投入以完成 design-in。尽管研发费用因 IC 团队的并入而增加，但得益于业务规模的快速扩张和毛利率的积极调整，利润增长依然可观。在当前的供需格局下，公司有能力有效传导成本压力，并通过规模效应扩大整体利润，以覆盖各项费用支出。当前阶段，平衡好现金流、利润与研发投入，在国产 AI 产业的起步期，成功卡位客户的供应链生态，是公司的首要任务，同时也将维持良好的利润增长趋势。

关于对慧能泰的并购，目前的整合进展如何，尤其在产品、技术及客户协同方面是否达到了预期？

慧能泰的整合进展顺利。工商变更及并表工作已经完成。技术层面，双方团队进行了深入沟通，已达成良好的协同效应，并制定了优化的技术路线图，旨在发挥各自优势，避免重复投资。从经营成果来看，慧能泰在 2026 年上半年已实现盈利，在内存供应紧张、消费电子板块普遍承压的背景下，其营收规模和利润均取得了良好增长，证明了此次并购的成功。未来，双方将深化合作，在人才、技术路线及 IP 协同方面持续推进良性的互动。此外，此次并购也为东微半导体带来了新的契机。公司计划利用 AI 技术赋能 IC 开发，通过投入 AI Agent 及模型算力，辅助完成开发过程中的基础性工作，以节省人力资源开支，实现用更少的人员达到更高的研发效率和成果。作为一个新进入 IC 领域的功率半导体公司，在当前时间点应用 AI 工具来提升效率，构成了公司在 AI 布局中的一项差异化竞争策略。

公司碳化硅业务上半年的增长显著，请问目前在产品落地、客户拓展方面的具体情况，以及对未来放量的节奏有何指引？

公司碳化硅业务在上半年实现了快速增长。经过过去两三年的研发，产品性能已达到国内第一梯队水平，并可与英飞凌等国际厂商的同级产品进行竞争。在客户拓展方面，进展非常顺利，已成功导入全球头部的汽车客户与算力客户。这些客户选择东微作为其少数几家国产供应商之一，用于其 AIDC（AI 数据中心）产品中。通过这些头部客户严苛的验证和质量审核体系，证明了公司产品的技术门槛和可靠性。随着国内外云服务厂商需求的增长，公司碳化硅业务的增长趋势非常明确。基于在手订单情况，对下半年的增长前景非常乐观。当前工作的重点是锁定上游产能，并已积极参与部分新增产能的建设。可以预见，碳化硅业务未来将实现高速增长，增速可能达到数倍甚至两位数的倍数增长。

公司中低压 MOSFET 业务在 2026 年上半年实现高速增长的核心驱动力是什么？对未来的增长空间有何预期？

上半年中低压 MOSFET 业务的高速增长，主要驱动力来自于 AI 领域的需求，该领域对低压产品的用量巨大。公司近几年在低压产品线上加大研发投入，产品的性能与可靠性获得了市场认可，并已成为头部客户 A 公司的主要供应商之一。其次，中低压产品本身的市场空间远大于高压产品，而公司在该领域的原有基数较小，因此增长表现尤为明显。公司的目标是在未来一到两年内，将高压产品的营收占比降至 50% 以下，低压产品线有可能成为公司第一大产品线。目前，公司已在 8 英寸和 12 英寸产线上锁定了大量产能，以满足未来的增长需求。个人对低压业务未来的增长前景非常乐观，其营收占比有望快速接近甚至超过高压产品。

超级结 MOSFET 业务在上半年营收出现小幅波动，请问公司未来的产品迭代计划和业务进展规划是怎样的？

超级结 MOSFET 业务营收与 2025 年同期基本持平。营收波动主要受 2026 年第一季度车规级需求断崖式下降的影响，当时春节假期较晚，且以比亚迪为代表的头部客户面临较大的库存压力，影响了公司主要应用于 OBC 的超级结产品出货量。目前，供应格局已恢复紧张，车规级客户的催货需求旺盛，公司正在消化 2025 年积累的库存，这部分库存在成本上具备一定优势。超级结 MOSFET 的市场规模不及低压产品，竞争格局已较为清晰，国内主要有两三家供应商。公司在该领域的策略是做好产品迭代和客户维护，实现稳健增长。增长将来源于两个方面：一是随市场需求的自然增长；二是通过国产替代进一步提升份额，特别是在 AIDC 领域，利用国外品牌缺货的时机，加大对原有市场份额较少的 AIDC 应用的渗透。

公司在人形机器人新业务赛道的产品布局如何？后续的业务进展规划是怎样的？

在人形机器人领域，公司的产品主要应用于关节电机和电源。目前，公司的 SGT 低压器件已在众多人形机器人关节供应商中实现大量出货，受益于 2026 年具身智能的放量，这部分业务增量显著。公司的策略一方面是稳固与现有客户的合作关系，另一方面是与客户联合研发新产品。目前正针对 48V 系统或更小型化的电机驱动模组，以及基于氮化镓的驱动模组和电源方案进行预研，并已取得良好成果。公司已与国内部分头部客户达成合作意向，正在进行具体规格需求的落地工作。随着行业的逐步发展，公司将能享受到该领域的增长红利，这也是公司的一项重要布局。

2026 年上半年公司的研发人员和研发投入显著增长，具体的研发方向和投入领域是哪些？

研发人员的增长主要源于 IC 团队的组建以及惠能泰的并入，补充了大量 IC 人才。同时，在功率器件产品线，特别是在氮化镓和碳化硅领域，也增加了少量研发人

员。IC 团队相对功率器件团队更多元化，涵盖模拟设计、数字设计、算法、应用及市场等多个方面，因此在这方面补充了许多资深人才。公司的研发战略正从过去围绕功率器件，转变为基于现有功率优势，开发更多围绕电能转换的差异化产品，特别是针对 800 伏和 48 伏系统的驱动和电源产品。这是面向下一代电力电子设备的布局，相关的研发投入，包括设备、仪器和实验室建设，未来会持续增加。

作为一家 Fabless 企业，公司在供应链方面采取了哪些措施来保障产能稳定？

供应链管理是当前非常重要的工作。除了与华虹和跃芯合作外，公司也在积极拓展更多的国内外 Fab 资源。目前，无论是客户还是 Fab，对供应商的要求都在提高，小型供应商很难获得头部客户的认可与导入，因为导入过程耗时、耗力、耗成本。客户在导入一家供应商时，会要求其具备持续供货、服务以及相应的资金能力。公司在供应链端通过提前下单、锁定产能等方式投入了大量资金，这与 IDM(如华润、士兰)和少数几家 Fabless 公司形成了稳定的阵营。在国内，Foundry 与 Fabless 是命运共同体，关系非常稳定。长期来看，公司能获得国内 Foundry 的充分支持，满足未来几年的产能需求，支撑公司更好的发展。保障产能是 2026 年的最重要工作之一。

公司在 2026 年下半年的主要发力赛道和增长逻辑是什么？

2026 年下半年将继续围绕 AI 和新能源相关赛道发力，深耕 AIDC、光伏、新能源汽车和高端工业电源等领域，以更好地释放公司的技术价值。在产品端，大硅预计将成为增量极高的赛道；同时，功率模块、传统 MOSFET 和数字控制 IC 在头部客户的放量也将有更好的表现。对于慧能泰的产品线，将通过降本增效，结合公司现有的客户资源优势，帮助其提高毛利率和市场覆盖率，扩大营收。整体而言，公司的增长将是多元化的，当前正处于一个利用过往积累的客户与产品资源，丰富生态系统，以支撑未来几年高速发展的良好时间点。

公司在脑机接口芯片领域的布局进展和后续发展规划是怎样的？

脑机接口项目目前在正常推进研发。由于脑机接口是一个需要长期持续研发的赛道，且该项目与上市公司并非直接关联，因此不便透露过多细节。公司的研发团队具备很强的竞争力和丰富的经验，正在持续推进研发工作。

在 AI 领域，结合对慧能泰的收购，公司相关产品的预期增速、市场占比提升以及客户拓展情况如何？

目前在 AI 领域，主要瓶颈不在于客户需求，而在于产能。未来的产能需求非常确定，特别是国产算力领域，虽然利润率可能不及英伟达，但其规模释放和长期高速成长的逻辑非常清晰，市场需求十分旺盛。因此，当前的第一要务是积极布局 and 拓展产能，以满足供给。公司并未设定具体的营收目标，因为当前受制于供

给能力。策略是在拥有足够订单的情况下，充分利用好现有产能，并优化产品结构以满足客户要求。

鉴于当前产业链普遍涨价，公司如何展望未来的价格趋势？同时，供给端的产能问题预计何时能得到缓解？

从近期至少一年来看，半导体供应链偏紧的态势很难得到缓解，无论是功率器件、BCD 电源制程，还是 28 纳米等先进工艺都比较紧张。因此，公司正积极布局产能，虽然短期内扩产困难，但在存量产能上已有良好布局。充分利用好现有产能，就可以支撑非常高速的增长。为应对产能瓶颈，公司一方面会进行产品升级，将常规产品升级为附加值更高的产品以提高价值量；另一方面会叠加 IC 产品的需求，IC 虽然产能也紧张，但其晶圆消耗量远小于功率器件，开发新的 IC 产品有助于更好地利用产能。综合来看，预计未来至少一年内，全行业的供给紧张状况看不到缓解的可能性。

公司 2026 年上半年的产品涨价动作、幅度如何？市场涨价对公司利润层面有何影响？

公司的涨价策略是与客户协商处理，而非统一发布涨价函。虽然上半年市场涨价函频出，但实际落地情况需参考各家财报。公司的策略是根据供应链成本调整和客户端的供需关系进行个案处理，以维护良好的客户关系。从目前情况看，第三季度的改善情况比较乐观，预计第四季度会更好，这是一个缓慢且持续改善的过程。如果明年（2027 年）供需关系更加紧张，调价的预期会更加明确。

目前公司自身以及下游渠道和客户的库存水平如何？

当前库存水平很低。客户端虽然可能存在一些策略性备货，但每家客户策略不同。总体来看，市场处于供不应求的状态。预计未来一年内，这种供不应求的状况会持续，确定性较高。

对于 2026 年及 2027 年的业绩和盈利能力，公司有何展望或指引？

预计 2026 年全年将实现非常大幅度的增长。从在手订单来看，目前的交付压力较大，公司正积极拓展新的产能平台并完成客户认证，以满足交货要求。

请总结公司当前所处的发展阶段以及未来展望。

2026 年对公司而言是关键的一年，公司正经历从功率器件供应商向“功率+IC”解决方案提供商的转型升级。同时，公司也面临着以 AI 为代表的新型电力系统更新换代的重大机遇。这是公司自成立、上市以来的第三个重要契机。通过并购和团队建设，为抓住这一机遇奠定了良好开端。此外，随着 AI 日新月异，公司有机会借助 AI 能力，以精简的团队规模和成本，提高运营



进行更多有价值的项目开发和创新。个人对此感到非常兴奋，这是一个从功率器件公司转型为整体解决方案半导体提供商的绝佳时机。

